

2022年11月16日

各位

会社名 K u d a n 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 項 大雨
(コード番号 4425 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 中山 紘平
(TEL. 03-4405-1325)

2023年3月期 第2四半期決算説明に関する質疑応答内容の公開のお知らせ

当社は、2022年11月15日、投資家・アナリスト向け決算説明会を開催いたしました。投資家の皆様にタイムリーに情報を開示するべく、質疑応答内容を本リリースにてテキストにて公開いたします。また、決算説明動画や決算説明スクリプト URL を以下に再掲しておりますので、あわせてご確認いただきますようお願い申し上げます。

【2023年3月期第2四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会】

1. 配信日時：2022年11月15日（火）
2. 説明者：代表取締役 CEO 項 大雨
取締役 CFO 中山 紘平
執行役員 CRO ティエン ハオ

▼▼決算説明動画はこちらからご確認いただけます▼▼

<https://youtu.be/HtvziKxLmDk>

▼▼決算説明スクリプトはこちらからご確認いただけます▼▼

<https://finance.logmi.jp/377470>

▼▼決算説明資料はこちらからご確認いただけます▼▼

<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02977/58730bc0/eb84/4f05/b878/6d36aca416c5/140120221110562679.pdf>

【質疑応答内容】

1. 今後御社の事業戦略上は半導体・センサ企業との製品化が最も重要と考えてよろしいでしょうか？また Intel との製品化による今後の売上規模の想定はございますか？

個別案件の売上金額については現時点では開示はしていませんが、Intel 社をはじめとする半導体やセンサ会社とのパートナーシップの影響を当社が戦略的にどのように見ているかご説明させていただきます。当社はディープテック（深層技術）企業のため産業のレイヤーにおいて積み木の一番下の部分にいて、上にはセンサ・半導体の層、その上に完成品の層、さらに上にサービス・ソリューションの層がございますが、基本的に当社の売上構造というのはこの業界の構造に合わせて多層的な構造になっております。つまり、各層それぞれが当社技術を調達することができる構造となっていて、どこかで当社技術が使われれば、最終的には最終顧客が使うサービス・ソリューションにおいて当社の技術が機能する仕組みとなっております。

当社としては全体の層の需要を喚起してその全体規模を上げていくところを基本的な戦略として考えていて、各層のバランスに関してはどちらかというと柔軟に対応していくという戦略を取っております。そのため、今回の Intel 社をはじめとする半導体・センサ企業とのパートナーシップにおける一番の戦略的なポイントとしては、全体の層の需要を喚起するということにありまして、当社の技術が例えば Intel 社のチップセットと組み合わせることにより上の層の各社も非常に使いやすくなり、当社技術の社会実装が進むということになります。

そうした点においては、当社は積み木の一番下という話をさせて頂きましたが、1 個上の半導体・センサの層をきちんと取り込んでいくことは非常に重要ですが、必ずしも Intel 社もしくはセンサ・半導体企業からの直接の収入だけが売上への貢献ではなく、これが呼び水となり、より上の層の各社からの売上が拡大していくということが、一番当社にとって重要になってきます。そのため、引き続きセンサ・半導体パートナーとの製品化を拡大しながら、これを呼び水として、全体的に様々な層の売上が組み合わさって事業成長していくというビジョンを持っております。

2. 現時点で来期の製品化確度高案件は 2 件とのことですが、最終的に何件ぐらい製品化するとの見込みはありますか？またその中で Intel のような大型の案件も予定していますでしょうか？

今期はもう既に 3 件製品化していて、最終的に 4 件の見込みでございますが、来期も基本的には今期と同等かそれ以上の製品化を見込んでおります。

来期に関しては現時点で確度が十分高まっている案件は 2 件ですが、来期に掛けて確度が高まり製品化に至る案件が出てくると想定しているため、基本的には今期からのペースを緩めることはないと考えております。

その中で、Intel 社のような大企業でかつ先程申し上げた各産業の層における売上拡大への呼び水になるような顧客としては、資料で開示している同業の NVIDIA 社のようなパートナーは同様に製品化をターゲットとして事業を進めております。ただし、顧客の会社規模がそのまま当社の事業に対するインパクトに比例するものではございません。当然大きい会社というのは売上を含む当社事業に対するインパクトは基本的には大きいですが、一方で小さい規模の会社であったとしても、当社の多層的な構造を考えたときに、上の階層の顧客が当社事業・技術を一気に引き上げて、そこで最終製品として世の中に出していくということは市場にとって技術の使い方

を示す先行事例として市場を広げていくという点で非常に有効と考えております。

当社技術はまだ次世代技術として、製品化を皮切りとして市場普及が始まったばかりのため、個別企業から売上を獲得するというよりも、それぞれのパートナーが業界の中で組み合わせたり、全体的にいかにか当社技術を使った製品群が広がっていくのかというところを強く意識してパートナーシップを広げている状況でございます。

3. 調達した 6.3 億円の資金使途について、もう少し具体的な内容と今期業績予想に与える影響について教えて頂けますでしょうか。

6.3 億円を調達したトランシェ①の資金使途に関しては、製品化した製品販売の拡大やさらなる製品化の達成・案件規模の拡大を想定していると開示しておりますが、より具体的には社内体制の拡充・強化のための事業開発・エンジニアの一定の採用コストが大きな部分になると考えております。

採用に関しては、当社のディープテック企業という性質を考えると原則としてこれまでの採用ペースを大きく加速することはないと考えておりますが、足元の大型案件の製品化を含む想定以上に事業が順調に進捗していることから、このような事業機会を捉えるために人の投資として、体制の拡充のために当期・来期で例えば年間で3から5名程度の規模で当初想定より採用が増える可能性はあるとみております。

ただしこのような投資を行ってでも今の事業開発・技術開発の良い流れを推し進めることが今後の当社の成長に大きく貢献すると考えております。

4. Kudan と Artisense の技術を統合した SLAM が完成した際の今後中長期的な売上への影響をご教示下さい。

この技術統合により、ハイブリッドの技術として次世代の SLAM 技術に置き換わっていきます。Kudan・Artisense 組み合わせの技術のため双方の良いところを備えていて、効果的に性能・安定性・処理速度全てにおいて改善するため、技術的な競争優位性として非常に画期的なものとなります。今足元で Intel 社製品に Kudan の技術が入っていくところですが、このような現時点では Kudan の技術が入っているものも今後は Artisense とのハイブリッド技術が入っていきます。

この一番のポイントとしては、個別の売上に繋がるというよりも、競争原理が変わっていくと考えていまして、例えば車でいうとトヨタ社がハイブリッドカーの技術を開発し市場投入したことにより、それまでその品質勝負だったところから一気にそのエコカーという別の競争軸が出てきて競合会社がこれを一朝一夕で真似することが難しくなると、売上以外にもブランドや人材獲得にも大きく寄与し、非常に有利なポジションを確保することができました。今はテスラ社が電気自動車と同じようなことをしていますが、当社の統合 SLAM もゲームチェンジをするような技術になると考えておりまして、今後の影響について申し上げますと、基本的には中長期的な売上成長全てに寄与するものと考えております。

5. INNOVIZ とは現在どのような協業を行っていて、また今後どのような協業へと拡大していく狙いでしょうか？

Innoviz 社とは事業共創パートナーとして、主にデジタルマッピングの領域に注力して協業を行っております。マーケットとしてはまずは日本を中心に取り組んでいますが、加えて APAC・アメリカでの具体的なニーズも出てきていて、エンドユーザーも含めて具体的な案件について協議している状況になります。

今後の拡大に関しては、Innoviz 社が最も得意としている自動運転の領域や、ロボティクス・スマートシティといった領域の方に対しても協業の範囲を広めていきたいと考えております。また事業開発という観点に加えて、技術面でも今後製品パートナーとしてのパートナーシップの深化について Innoviz 社と協議をしております。

6. 製品パートナー（Intel と同じような形）として想定している企業はどのくらいありますか？たとえば NVIDIA などそのような対象になるのでしょうか。

NVIDIA 社、Ouster 社、Innoviz 社等決算説明資料において半導体・センサパートナーとして開示している会社とは製品パートナーに向けて注力して参ります。

7. ライセンス売上の規模について、UCS 社の製品が複数売れたとのことだが、金額的にはどの程度でしょうか？

まだ販売開始間もないことからここまでの売上金額は大きくなく、販売が拡大するのは来期以降の想定となっております。

なお、具体的な個別案件の売上に関して現在は開示をしておりませんが、今後の更なる製品化及び製品ライセンス売上の拡大に伴い、来期以降の製品ライセンス売上金額の開示方法については検討して参ります。

8. 次年度の売上増はどの程度期待できるのでしょうか？

次年度の売上増に関しては、足元で事業が大きく動いていて現時点で見積もることが難しい状況ではありますが、現在事業進捗として注目頂いている顧客製品化の進捗以外にも、大型の開発案件が多く受注出来ていて好調な状況でございます。そのため、前期から当期に掛けての想定する売上の伸びは原則として開発案件だけでも来期も維持されるものと見込んでおります。それに加えて、ソリューションや製品化案件からの売上が来期は上乘せされるものとみております。来期はまだ売上の大部分が開発案件となる想定ですが、加えてソリューション売上や製品ライセンス売上も始まり、売上獲得のパターンとして厚みを増していきますし、こうしたお互いの案件が絡みあってさらに新しい案件へとつながるような事業展開の盛り上がりも期待しております。

9. Intel 製品に採用されたベースは Kudan のものなのか、Artisense のものなのか、技術統合後の SLAM なのか、こういった背景のものでしょうか？

Intel 社とは約 2 年前から取り組みを行っているため、現時点で Intel 製品に採用されているのは Kudan の SLAM になります。ただし、Artisense と統合した SLAM についても、より幅広いユースケースへの適用が可能になるため、今後は Intel 製品においても採用に向けて進めていきたいと考えております。

10. 同じ分野(例えばマッピング)で複数の会社と提携することは可能なのでしょうか？その場合の条件などはあるのでしょうか？

こちらは可能です。例えばマッピングでお話しますと、それが建設なのか、測量分野なのか、それとも点検インフラのマネジメントなのか、マッピングという大きな分野の中においても複数のユースケースがございますので、その中で具体的にどの領域を得意としているいくつかの会社と提携するケースは十分にあり得ます。

この場合の条件としては、地理的な親和性やその背後にある顧客ベース（例えば、アカデミックに強いのか、特定客層に強いのか等）などが提携する条件として考えております。

なお、当社がディープテック領域にこだわり独立系を維持しているのは、深く潜ることで当社の顧客が強豪同士だとしても両方に対して技術を提供できるポジションを確保するというのが重要になっております。これまでも当社は CPU アーキテクチャの ARM 社のように深く潜る会社を目指すということを申し上げておりましたが、ARM 社は製品を多くの半導体メーカーに売っていますが、それぞれの半導体メーカーは全社競合同士となっています。この技術を自社で開発するには深すぎてニッチ過ぎるため、このような大きい会社がやりづらいところを抑えることによって、深く潜って薄く広がることができているし、当社もそのようなポジションを狙っております。

その中で、申し上げました通り、地域やユースケースごとに濃淡をつけて戦略的に一番収益を上げやすいところにある程度フォーカスする部分もありますが、大前提として、必ずしもどこか 1 箇所のところに完全に抱えられてしまって他のところに手出しできないというポジションを当社は取ることはなく、そのため独立ポジションを維持した経営をしています。

11. 四半期営業黒字が達成できる時期はいつでしょうか。

当社事業としては、顧客のプロジェクトが通常四半期以下の単位ではなく半年や 1 年以上というスパンで動いているものがほとんどのため、経営上四半期ではなく通年ベースで採算や損益を見ております。

そのため通年での営業黒字の達成について申し上げますと、基本的には来期には黒字体質を目指す目標について現状変更はございません。ただし、ここまでお話ししてきた足元の事業進捗を

踏まえて、どのように今後必要な投資を行い、事業を延ばし、将来売上のポテンシャルを高めていくかという点も今後の成長に重要と考えておりますため、そうした点も考慮しながら継続して目指すべき売上及び利益についての検討を進めていきたいと考えております。

※決算説明の内容に関するご質問につきましては、下記の問い合わせ先にて頂戴いたします。また、ご希望の会社様には、個別取材も承りますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

■会社概要

会 社 名：K u d a n株式会社

証券コード：4425（東証グロース）

代 表 者：代表取締役 CEO 項 大雨

■お問い合わせ先は[こちら](#)